

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2025-012

芯原微电子（上海）股份有限公司 关于近期经营情况的自愿性信息披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和性依法承担法律责任。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯原股份”或“芯原”）是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processor IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。凭借长期保持在 30% 以上营收占比的高研发投入，芯原一直走在科技发展的前列，并且已经在 AI 领域取得丰富的成就。例如，芯原全球领先的 NPU IP 已在 82 家客户的 142 款 AI 类芯片中获得采用，覆盖服务器、汽车、智能手机、可穿戴设备等 10 余个市场领域，集成芯原 NPU IP 的 AI 类芯片已出货超 1 亿颗，目前已经支持运行 DeepSeek。芯原用于高性能 AI 计算的 GPU 和 GPGPU-AI IP 还在全球范围内获得多次架构授权，在众多高性能计算产品中获得应用。芯原的 GPU IP 同样表现出色，被数据中心、汽车电子、可穿戴设备、PC 等领域广泛采用，内置芯原 GPU 的客户芯片已在全球出货超过 20 亿颗。

基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。除服务 IC 设计客户外，芯原近年来约 40% 的收入来自于系统厂商、互联网公司、云服务供应商、车企等非 IC 设

计公司，约 80% 的芯片定制服务业务收入采用 14 纳米或以下的先进工艺。基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。

近年来，汽车行业正经历“电动化、智能化、无人化、网联化”的变革，智能出行时代已经到来。公司聚焦快速增长的自动驾驶领域，目前，公司车规级高性能自动驾驶系统级芯片（SoC）设计平台已完成验证，并在客户项目上成功实施。基于芯原的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）业务模式，该平台可为自动驾驶、智能驾驶辅助系统（ADAS）等高性能计算需求的场景提供强大的技术支持。

芯原的芯片设计流程已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系认证，可从芯片和 IP 的设计实现、软件开发等方面，为全球客户满足功能安全要求的车载芯片提供一站式定制服务。结合公司自有的丰富的车规级 IP 组合，以及完整的自动驾驶软件平台框架，芯原可为客户提供从芯片设计、验证到车规认证的全流程支持，包括安全需求分析、架构设计和认证支持等。

芯原的车规级高性能自动驾驶 SoC 设计平台采用灵活可配置的架构，支持高性能多核中央处理器（CPU）、图像信号处理器、视频编解码器和神经网络处理器等多个协处理器高效协同工作，可选配内置 ASIL D 等级的功能安全岛，并支持高速高带宽存储子系统，具备优秀的数据吞吐和实时处理能力。该平台还针对包含 5nm 和 7nm 在内的先进车规工艺制程进行了优化，兼具优异的功耗、性能和面积（PPA）特性。

目前，全球车企正在积极布局 ADAS 和自动驾驶技术，以抢占汽车工业的下一个发展高地，并借助相关技术积累，进一步向机器人应用迈进。ADAS 和自动驾驶芯片面临设计周期长、单芯片（大芯片）良率较低、生产受限以及算力扩展困难等挑战，采用 Chiplet 技术可以有效解决这些问题，并已在汽车产业届达成共识：2023 年 10 月，汽车生态系统在 IMEC 召开第二届汽车 Chiplet 会议，各方形成共识：“无论如何，Chiplet 都将成为未来汽车的一部分”。

2023 年 11 月，瑞萨发布了第五代汽车芯片战略，明确表示将会采用 Chiplet 架构，并在 2027 年提供基于 Chiplet 架构的 SoC、MCU 等系列产品；2024 年 10 月，博世与 Tenstorrent 宣布合作，开发用于汽车芯片的 Chiplet 标准化平台。Chiplet 已是全球高端智慧驾驶的共识，也是芯原的战略发展方向之一。

公司已于 5 年前开始布局 Chiplet 技术的研发。芯原当下正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的发展和产业化，通过竞争力升维来拓展更广阔的市场空间。目前，芯原已在基于 Chiplet 的生成式人工智能大数据处理和高端智驾两大赛道实现领跑，正在推进基 Chiplet 架构、面向智驾系统和 AIGC 高性能计算的芯片平台研发项目，这些项目已经取得了优秀的阶段性成果。

基于公司车规认证的芯片设计流程、车规级 IP 和完整的软件服务，芯原已成功为客户提供基于先进车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务；目前正在推进高端智慧驾驶的 Chiplet 平台的研发和产业化。未来，芯原将继续深化汽车领域的技术创新，助力智慧汽车行业实现更高水平的安全性与智慧化。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日